



VIA Technologies, Inc.

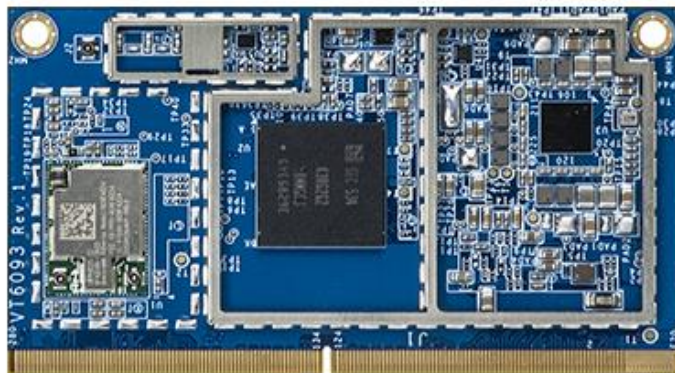
531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820 エンベデッドプラットフォームを採用した VIA SOM-9X20 を発表

一次世代のエンタープライズ IoT および組み込み機器の開発を加速する
高度に統合化された超小型システムオンモジュール

2017 年 10 月 27 日 台湾・新北市 - VIA Technologies, Inc.は台湾時間の 10 月 26 日、Qualcomm Incorporated の子会社である Qualcomm Technologies, Inc の Qualcomm® Snapdragon 820 エンベデッド・プラットフォームを採用した VIA SOM-9X20 システム・オン・モジュール (SoM) を発表しました。

VIA SOM-9X20 は、最先端性能と低消費電力性能を両立した超小型 SoM で、さまざまなエンタープライズ IoT および組み込みシステムアプリケーションの迅速な開発を可能にする柔軟性の高いソリューションを提供、マン・マシン・インターフェース (HMI)、監視、デジタルサイネージからロボット、カメラ、ビデオ会議に至るまで、幅広く利用できます。



「最先端のコンピューティング、グラフィックス、ビデオ機能と高度なワイヤレス接続、低消費電力性を組み合わせた Snapdragon 820 は、次世代のエンタープライズ IoT と組み込み機器のパフォーマンスや電力効率に関する厳しい要件を満たします」と、VIA Technologies の国際マーケティング担当 VP の Richard Brown は語ります。「SOM-9X20 は、急速に普及しているマシンインテリジェンス、コンピュータビジョン、拡張現実やバーチャルリアリティなどのアプリケーション向けに、魅力的な 4K ビデオ機能を備えた画期的な新製品の開発を加速できるように設計されています」

「Snapdragon 820 組み込みプラットフォームは、最先端のエンタープライズ IoT デバイスに求められるパフォーマンス、エネルギー効率、接続性を提供します。シナリオ、およびユースケースを迅速に作成する

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820 エンベデッドプラットフォームを採用した VIA SOM-9X20 を発表

2/3

のに役立つ、超小型 SoM で利用可能な Snapdragon を提供しています」と Qualcomm Technologies, Inc.の事業開発担当副社長の Jeffery Torrance 氏は述べています。「VIA が Snapdragon を超小型 SoM で採用したことをうれしく思います。これにより、開発者は新しくエキサイティングな商用 IoT システム、シナリオ、およびユースケースを迅速に開発することに役立つはずです」

Snapdragon 820 プロセッサ

Snapdragon 820 プロセッサには、以下のような機能があります。

- Qualcomm® Kryo™ CPU: 最高性能と低消費電力を実現するように設計されたクライオは、Qualcomm Technologies の最初のカスタム 6bit クアッドコア CPU で、14nm FinFET LPP プロセス先端技術で製造されています
- Qualcomm® Adreno™ 530 GPU: 従来の世代よりも消費電力を削減しながら、視覚的忠実度を向上させるために、グラフィックスおよびコンピューティングパフォーマンスを最大 40%向上させています
- Qualcomm Spectra™ 14bit デュアルイメージシグナルプロセッサ (ISP) は、ヘテロジニアス・コンピューティングを使用して高解像度の DSLR 画質イメージを提供し、高度な処理と追加の省電力を実現し、ゼロシャッタラグで最大 28MP のセンサをサポート
- Qualcomm Hexagon™680 DSP には、Hexagon Vector eXtensions (HVX) と、一定のセンサー処理用の Low Power Island 搭載センサーコアが含まれています

VIA SOM-9X20

VIA SOM-9X20 は、Snapdragon™ 820 エンベデッドプラットフォームにより高集積化されたシステムオンモジュールです。わずか 8.2cm×4.5cm のこのモジュールは、64GB の eMMC フラッシュメモリと 4GB の LPDDR4 SDRAM をオンボードで搭載し、USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0 および USB 2.0 を含む MXM 3.0 314 ピンコネクタを通じて豊富な I/O およびディスプレイ拡張オプションを提供します。また、SDIO、PCIe、MIPI CSI、MIPI DSI、UART、I2C、SPI、GPIO 用の多機能ピンなどにも対応しています。

また、VIA SOM-9X20 モジュールは、GNSS / GPS RF レシーバ、BT 4.1、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac など、2 つのアンテナコネクタを備えた統合コンボモジュールを含み、あらゆるワイヤレス接続に対応します。

VIA SOM-9X20 BSP には、Android 7.1.1 と、システムクラッシュから保護するウォッチドッグタイマー (WDT)、GPIO アクセス、オートパワーオンの RTC などの API や、サンプルアプリケーションなどを含む VIA Smart ETK (組み込みツールキット) から構成される BSP が付属します。

さらに、実用化までの時間を短縮し、開発コストを最小限に抑えるハードウェアとソフトウェアのカスタマイズサービスのフルセットが利用可能です。ご興味のある方には、完全なターンキー開発サービスを提供することもできます。

VIA SOM-9X20 の詳細については、次の URL を参照してください。

<https://www.viatech.com/ja/boards-j/modules/som-9x20/>

このリリースに関連する画像については、<https://www.viagallery.com/som-9x20/> をご覧ください。

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820 エンベッドプラットフォームを採用した VIA SOM-9X20 を発表

3/3

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットフォームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<https://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。

Qualcomm、Snapdragon、Kryo、Adreno、および Hexagon は、米国およびその他の国における Qualcomm Incorporated の商標です。Qualcomm Spectra は、Qualcomm Incorporated の商標です。

Qualcomm Snapdragon、Qualcomm Kryo、Qualcomm Adreno、Qualcomm Hexagon、および Qualcomm Spectra は、Qualcomm Technologies, Inc. の製品です。

ここに記載されている実際の企業および製品名は、それぞれの所有者の商標です。